



Agenda zur BMBF Auftaktveranstaltung

„Technologien zur Systemintegration für zukünftige Elektroniksysteme" (TechSys)

Ort: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) - Berlin
Konferenzsaal Alexander von Humboldt 2
Kapelle-Ufer 1
10117 Berlin

Datum: 12. Oktober 2017

09:00 - 09:30 **Registrierung und Begrüßungskaffee**

09:30 – 10:00 **Begrüßung durch das BMBF**

10:00 – 10:55 **Session 1 – Leiterplattentechnologien – embedding**

PEKOS - Neue Prozesstechnologien zur Einbettung von Elektronikkomponenten in großflächige organische Substrate

Dr. Andreas Ostmann – Fraunhofer IZM

ThermoFreq - Laserbasierte Technologieplattform zum Aufbau robuster Leistungselektroniksysteme

Klaus Wilke - Siemens AG

MODAL - Modularer Technologie-Baukasten für hochkompakte Elektroniksysteme auf Leiterplattenbasis

Stephanie Groß - Conti Temic GmbH

10:55 – 11:25 **Kaffeepause und Networking**

11:25 – 13:00 **Session 2 – Hybridintegration – HF-Elektronik**

TARANTO (aus der Förderinitiative ECSEL-JU) - Elektroniksysteme für Radar- und Kommunikationslösungen der nächsten Generation

Dr. Wolfgang Dettmann – Infineon Technologies AG

HyTeck - Hybridintegrationsplattform für zuverlässige Hochfrequenz-Schaltkreise

Dr. Gerhard Kahmen - Rohde & Schwarz GmbH

CoGaN - Neuartige Packaging-Technologie für Galliumnitrid basierte Hochfrequenz-Elektroniksysteme

Dr. Klaus Riepe - UMS GmbH



	<p>HYPATIA - Hybride Packaging Technologie für Innovative 300 GHz Radar Anwendungen <i>Dr. Christian Frank - Sikora AG</i></p> <p>MIIMOSYS - Technologien und Prozesse zur Heterointegration leistungselektronischer Systeme <i>Ralf Lerner – X-Fab Semiconductor Foundry AG Erfurt</i></p>
13:00 – 14:00	Mittagspause und Networking
14:00 – 15:15	Session 3 – Packaging-Technologien – Glas/Keramik <p>FELAF (<i>aus der Förderinitiative KMU-innovativ</i>) - Faserverbundintegriertes Elektroniksystem zur langzeitzuverlässigen Füllstandsmessung <i>Hans-Joachim Lätzsch – Lätzsch GmbH Kunststoffverarbeitung</i></p> <p>GlaRa - Glasinterposer-Technologie zur Realisierung hochkompakter Elektroniksysteme für Hochfrequenzanwendungen <i>Dr. Malte Schulz-Ruhtenberg - LPKF AG</i></p> <p>PRISMA - Integrationsplattform für mikromechanische und -optische Elektroniksysteme auf Basis funktioneller Glasgehäuse <i>Dr. Stefan Weinberger - X-Fab MEMS Foundry Itzehoe GmbH</i></p> <p>RobopS - Neue Gehäusetechnologien für optoelektronische Sensorsysteme <i>Dr. Dominik Jurkow - Via electronic GmbH</i></p>
15:15 – 15:40	Kaffeepause und Networking
15:40 – 16:40	Session 4 – Diverse Systemintegrationstechnologien <p>HYB-Man - Hybrid additiv 3D-gefertigte smarte Elektroniksysteme <i>Bernhard Polzinger – Robert Bosch GmbH</i></p> <p>Texas - Baukasten für multifunktionale textiladaptierte Elektroniksysteme <i>Volkmar Reichmann - TITV e.V.</i></p> <p>ADAMOS - Systemintegrationstechnologien für multifunktionale folienbasierte Elektroniksysteme <i>Dr. Florian Grimminger - Infineon Technologies AG</i></p>
16:40 - 17:00	Schlusswort und Diskussionsrunde
17:00	Ende der Veranstaltung